

**TIF™ 050-11** 是一种软硅凝胶间隙填充垫。这硅凝胶混合了填料，加上独特配方，使其拥有良好导热性能，亦保留了其极软的特性。

因为**TIF™ 050-11**比一般的导热硅油的粘度为高，它能防止黏合物与填料分离的现象。另外它的黏合线偏移也比传统的散热垫控制得好。

**TIF™ 050-11**的使用方法跟散热脂类似，可使用商业上一些方法包括丝网印刷，注射或自动化设备操作。

**TIF™ 050-11**的应用包括倒装芯片微处理器，PPGAs，微型BGA封装，BGA封装，DSP晶片，圆形加速晶片，LED照明和其他高功率的电子元件。

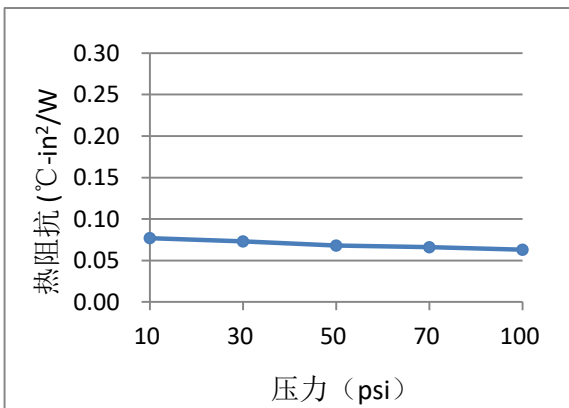
## 特性

- 》良好的热传导率: **5.0 W/mK**
- 》柔软, 与器件之间几乎无压力
- 》低热阻抗
- 》可轻松用于点胶系统自动化操作
- 》长期可靠性

## 应用

- 》散热器底部或框架
- 》LED液晶显示屏背光管, LED电视, LED灯具
- 》高速硬盘驱动器
- 》微型热管散热器 》汽车发动机控制装置
- 》通讯硬件 》半导体自动试验设备

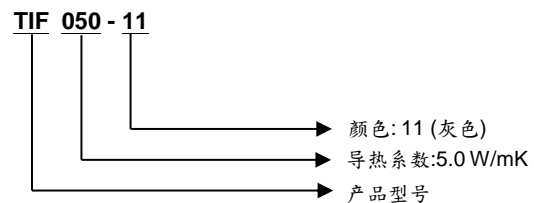
## 热阻抗



TIF™ 050-11 系列特性表

颜色	灰色	目视
结构&成份	陶瓷填充硅材料	*****
粘度	2000,000cps	GB/T 10247
比重	3.05 g/cc	ASTM D297
导热系数	5.0 W/mK	ISO 22007-2
热扩散系数	1.695 mm²/s	ISO 22007-2
比热容	2.3 MJ/m³K	ISO 22007-2
使用温度范围	-45 ~200°C	*****
耐电压强度	200 V/mil	ASTM D149
防火等级	94V0	E331100
总质量损失 (TML)	0.60%	ASTM E595

## 产品型号说



## 产品规格:

•30 cc/支, 98支/箱; 300 cc/支 6支/箱  
或在注射器用于自动化应用定制包装。 如欲了解不同规格产品信息请与本公司联系。

如果您想了解更多导热材料的产品信息, 请访问我司官网: <http://www.ziitek.com>



导热灌封胶 | 相变化材料 | 导热矽胶布 | 导热膏 | 导热双面胶 | 导热硅胶片 | 屏蔽材料 | 石墨片 | 导热塑料

### 加拿大:

Tel: +001-604-2998559  
E-mail: sales@thermazig.com

### 台湾:

Tel: +886-2-22771007  
Fax: +886-2-22771075  
E-mail: frances@ziitek.com.tw

### 东莞:

Tel: +86-769-38801208  
Fax: +86-769-83791290  
E-mail: angus@ziitek.com

### 昆山:

Tel: +86-512-57816297  
Fax: +86-512-57816327  
E-mail: kelvin@ziitek.com

### 成都:

Tel: +86-28-62379168  
Fax: +86-28-62379168  
E-mail: david\_cd@ziitek.com

以上资料与说明相信是可靠的但不作为法律的解释或保证. 用户须进行充分的测试与确认上述讯息适合用户所提出任何特殊的产品与应用。